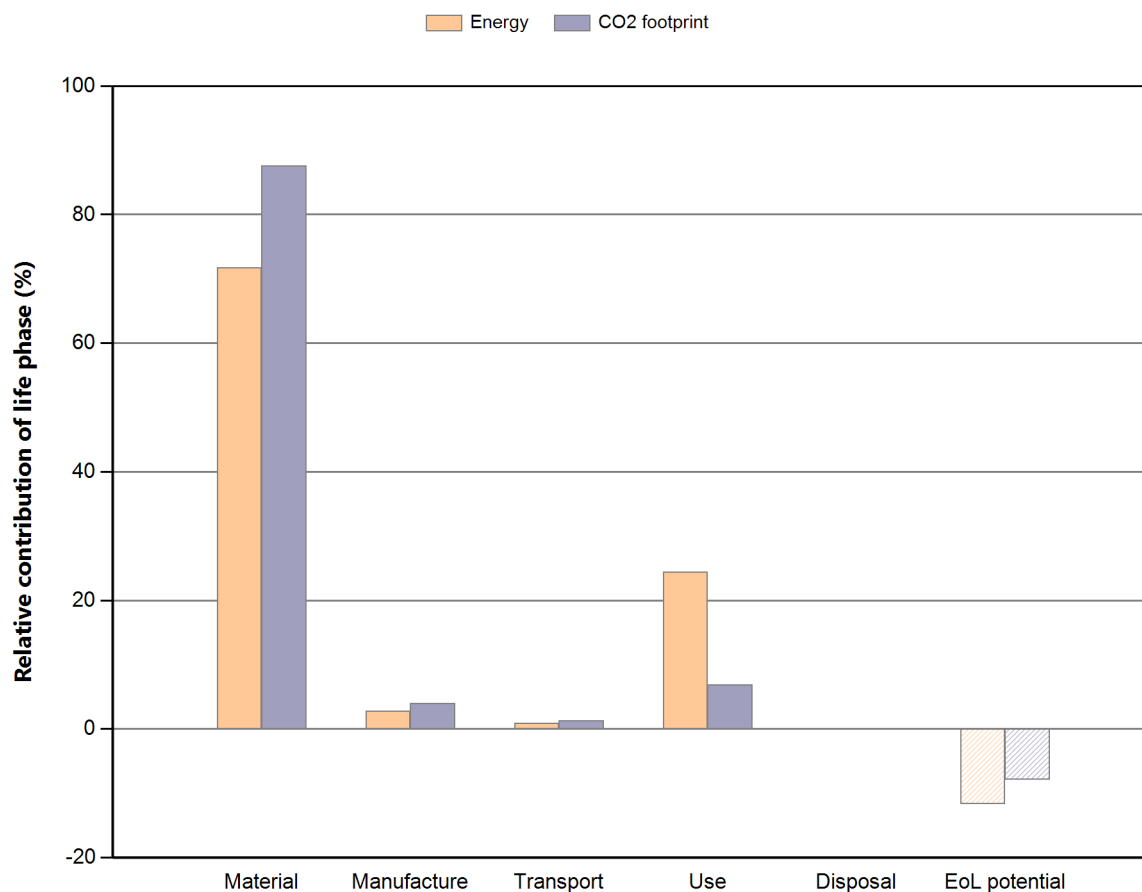


Eco Audit Report

Product name PS2
Country of use France
Product life (years) 8

Summary:



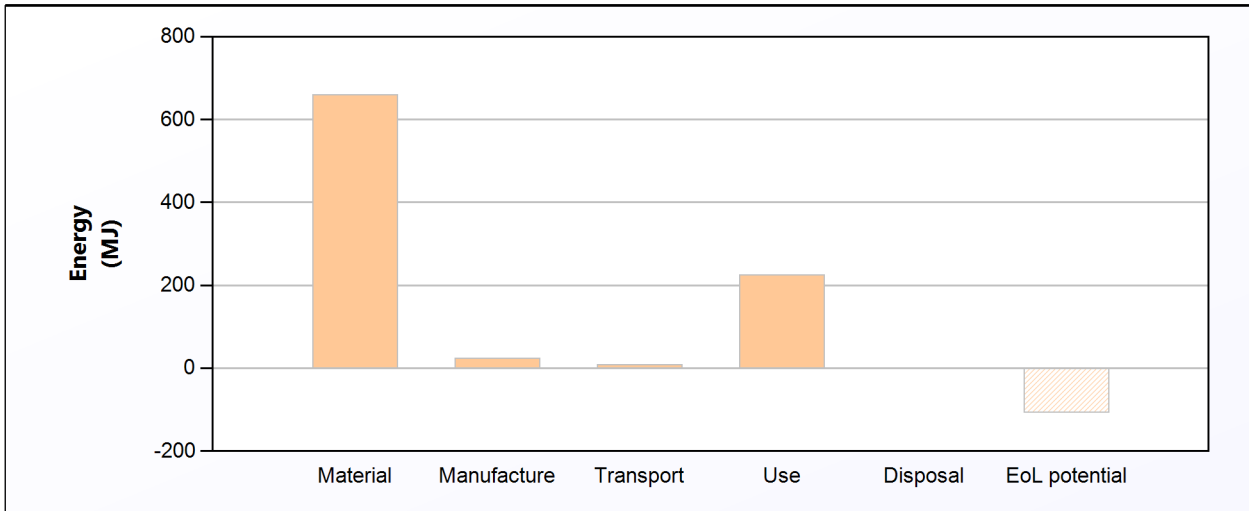
[Energy details](#)

[CO2 footprint details](#)

Phase	Energy (MJ)	Energy (%)	CO2 footprint (kg)	CO2 footprint (%)
Material	661	71,8	41,7	87,6
Manufacture	25,4	2,8	1,91	4,0
Transport	8,89	1,0	0,64	1,3
Use	226	24,5	3,3	6,9
Disposal	0,384	0,0	0,0269	0,1
Total (for first life)	921	100	47,6	100
End of life potential	-107		-3,75	

Energy Analysis

[Summary](#)



	Energy (MJ/year)
Equivalent annual environmental burden (averaged over 8 year product life):	115

Detailed breakdown of individual life phases

Material:

[Summary](#)

Component	Material	Recycled content* (%)	Part mass (kg)	Qty.	Total mass (kg)	Energy (MJ)	%
Boîtier	ABS (20% glass fiber, injection molding)	Virgin (0%)	1,2	1	1,2	1,1e+02	16,7
Carte mère	FR-4, Epoxy/Glass fiber, PCB laminate	Virgin (0%)	0,17	1	0,17	63	9,5
Processeur + GPU	Single crystalline silicon, electronics	Virgin (0%)	0,08	1	0,08	4e+02	60,0
RAM	FR-4, Epoxy/Glass fiber, PCB laminate	Virgin (0%)	0,02	1	0,02	7,4	1,1
Lecteur DVD	Aluminum, commercial purity, S150.1: LM0-M, cast	Virgin (0%)	0,25	1	0,25	50	7,5
Cables	Cable	Virgin (0%)	0,1	1	0,1	9,1	1,4
Ventilateur	Fan	Virgin (0%)	0,1	1	0,1	25	3,7
Total				7	1,9	6,6e+02	100

*Typical: Includes 'recycle fraction in current supply'

Manufacture:[Summary](#)

Component	Process	Amount processed	Energy (MJ)	%
Boîtier	Polymer molding	1,2 kg	22	86,0
Carte mère	Compression molding	0,17 kg	0,6	2,3
RAM	Compression molding	0,02 kg	0,07	0,3
Lecteur DVD	Casting	0,25 kg	2,9	11,4
Total			25	100

Transport:[Summary](#)**Breakdown by transport stage**

Stage name	Transport type	Distance (km)	Energy (MJ)	%
Fournisseur composants -> Usine Chine	Ocean freight	5e+02	0,17	1,9
Assemblage (ex. Shenzhen) -> Le Havre	Ocean freight	2e+04	6,9	77,8
Le Havre -> Entrepôt régional	32 tonne (4 axle) truck	5e+02	0,9	10,2
Entrepôt -> Magasin Brest	32 tonne (4 axle) truck	5e+02	0,9	10,2
Total		2,2e+04	8,9	100

Breakdown by components

Component	Mass (kg)	Energy (MJ)	%
Boîtier	1,2	5,6	62,5
Carte mère	0,17	0,79	8,9
Processeur + GPU	0,08	0,37	4,2
RAM	0,02	0,093	1,0
Lecteur DVD	0,25	1,2	13,0
Cables	0,1	0,46	5,2
Ventilateur	0,1	0,46	5,2
Total	1,9	8,9	100

Use:

[Summary](#)

Static mode

Energy input and output type	Electric to thermal
Country of use	France
Power rating (W)	45
Usage (hours per day)	1
Usage (days per year)	1,5e+02
Product life (years)	8

Relative contribution of static and mobile modes

Mode	Energy (MJ)	%
Static	2,3e+02	100,0
Mobile	0	
Total	2,3e+02	100

Disposal:

[Summary](#)

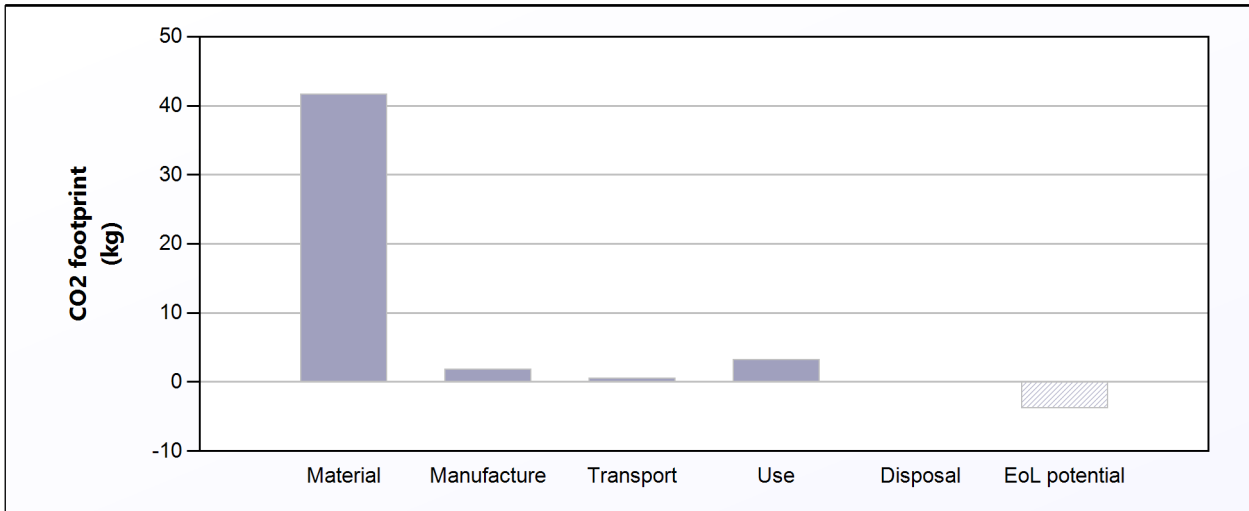
Component	End of life option	Energy (MJ)	%
Boîtier	Re-manufacture	0,24	62,5
Carte mère	Landfill	0,034	8,9
Processeur + GPU	Landfill	0,016	4,2
RAM	Landfill	0,004	1,0
Lecteur DVD	Landfill	0,05	13,0
Cables	Landfill	0,02	5,2
Ventilateur	Landfill	0,02	5,2
Total		0,38	100

EoL potential:

Component	End of life option	Energy (MJ)	%
Boîtier	Re-manufacture	-1,1e+02	100,0
Carte mère	Landfill	0	0,0
Processeur + GPU	Landfill	0	0,0
RAM	Landfill	0	0,0
Lecteur DVD	Landfill	0	0,0
Cables	Landfill	0	0,0
Ventilateur	Landfill	0	0,0
Total		-1,1e+02	100

CO2 Footprint Analysis

[Summary](#)



	CO2 (kg/year)
Equivalent annual environmental burden (averaged over 8 year product life):	5,95

Detailed breakdown of individual life phases

Material:

[Summary](#)

Component	Material	Recycled content* (%)	Part mass (kg)	Qty.	Total mass (kg)	CO2 footprint (kg)	%
Boîtier	ABS (20% glass fiber, injection molding)	Virgin (0%)	1,2	1	1,2	4	9,6
Carte mère	FR-4, Epoxy/Glass fiber, PCB laminate	Virgin (0%)	0,17	1	0,17	2,6	6,2
Processeur + GPU	Single crystalline silicon, electronics	Virgin (0%)	0,08	1	0,08	30	71,3
RAM	FR-4, Epoxy/Glass fiber, PCB laminate	Virgin (0%)	0,02	1	0,02	0,3	0,7
Lecteur DVD	Aluminum, commercial purity, S150.1: LM0-M, cast	Virgin (0%)	0,25	1	0,25	3,2	7,7
Cables	Cable	Virgin (0%)	0,1	1	0,1	0,68	1,6
Ventilateur	Fan	Virgin (0%)	0,1	1	0,1	1,2	2,8
Total				7	1,9	42	100

*Typical: Includes 'recycle fraction in current supply'

Manufacture:[Summary](#)

Component	Process	Amount processed	CO2 footprint (kg)	%
Boîtier	Polymer molding	1,2 kg	1,6	85,8
Carte mère	Compression molding	0,17 kg	0,048	2,5
RAM	Compression molding	0,02 kg	0,0056	0,3
Lecteur DVD	Casting	0,25 kg	0,22	11,4
Total			1,9	100

Transport:[Summary](#)**Breakdown by transport stage**

Stage name	Transport type	Distance (km)	CO2 footprint (kg)	%
Fournisseur composants -> Usine Chine	Ocean freight	5e+02	0,012	1,9
Assemblage (ex. Shenzhen) -> Le Havre	Ocean freight	2e+04	0,5	77,8
Le Havre -> Entrepôt régional	32 tonne (4 axle) truck	5e+02	0,065	10,2
Entrepôt -> Magasin Brest	32 tonne (4 axle) truck	5e+02	0,065	10,2
Total		2,2e+04	0,64	100

Breakdown by components

Component	Mass (kg)	CO2 footprint (kg)	%
Boîtier	1,2	0,4	62,5
Carte mère	0,17	0,057	8,9
Processeur + GPU	0,08	0,027	4,2
RAM	0,02	0,0067	1,0
Lecteur DVD	0,25	0,083	13,0
Cables	0,1	0,033	5,2
Ventilateur	0,1	0,033	5,2
Total	1,9	0,64	100

Use:

[Summary](#)

Static mode

Energy input and output type	Electric to thermal
Country of use	France
Power rating (W)	45
Usage (hours per day)	1
Usage (days per year)	1,5e+02
Product life (years)	8

Relative contribution of static and mobile modes

Mode	CO2 footprint (kg)	%
Static	3,3	100,0
Mobile	0	
Total	3,3	100

Disposal:

[Summary](#)

Component	End of life option	CO2 footprint (kg)	%
Boîtier	Re-manufacture	0,017	62,5
Carte mère	Landfill	0,0024	8,9
Processeur + GPU	Landfill	0,0011	4,2
RAM	Landfill	0,00028	1,0
Lecteur DVD	Landfill	0,0035	13,0
Cables	Landfill	0,0014	5,2
Ventilateur	Landfill	0,0014	5,2
Total		0,027	100

EoL potential:

Component	End of life option	CO2 footprint (kg)	%
Boîtier	Re-manufacture	-3,8	100,0
Carte mère	Landfill	0	0,0
Processeur + GPU	Landfill	0	0,0
RAM	Landfill	0	0,0
Lecteur DVD	Landfill	0	0,0
Cables	Landfill	0	0,0
Ventilateur	Landfill	0	0,0
Total		-3,8	100

Notes:

[Summary](#)